

LPTBG19A

产品特性 Product Features :

芯片尺寸 Dimensions : 19mil x 19mil
(475±50um x475±50um)

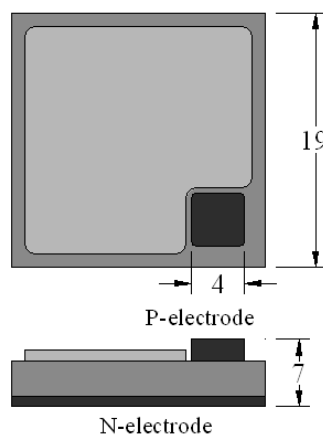
芯片厚度 Chip Thickness : 7mil(175±20um)

焊盘尺寸 Pad Size : 4mil(100±10um)

焊盘金属 Pad Material :

N 焊盘 (N PAD) : Au

P 焊盘 (P PAD) : Au



单位: mil

光电性能 (Electronic Parameters) ,TA=25°C

参数 Parameters	符号 Symbol	条件 Condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
开启电压 Turn-On Voltage	Vf1	If=10μA	2.0	---	2.8	V
工作电压 Forward Voltage	Vf2	If=150mA	2.8	3.2	3.4	V
反向漏电流 Reverse Leakage Current	IR	Vr=8V	---	---	2	μA
主波长 Dominate Wavelength	λd	If=150mA	445	---	465	nm
半波宽度 FWHM	Δλ	If=150mA	---	---	30	nm
光功率 Luminous Power	Po	If=150mA	170	---	240	mW